

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-004

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投 项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“盛美上海”）于2025年1月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”，并将该项目拟投入募集资金24,500.00万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）变更至首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZI10561号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

根据《盛美上海首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-019）、《关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的公告》（公告编号：2023-015）及《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-043），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	盛美半导体设备研发与制造中心	70,000.00	120,000.00
2	盛美半导体高端半导体设备研发项目	45,000.00	45,000.00
3	补充流动资金	65,000.00	65,000.00
4	高端半导体设备拓展研发项目	73,087.15	73,087.15
5	盛美韩国半导体设备研发与制造中心	24,500.00	24,500.00
	合计	277,587.15	327,587.15

三、募集资金投资项目投入情况

截至2024年9月30日，公司募投项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	拟使用募集资金金额	累计投入金额	投入进度
1	盛美半导体设备研发与制造中心	盛唯半导体设备（上海）有限公司	120,000.00	121,649.30	101.37%
2	盛美半导体高端半导体设备研发项目	公司	45,000.00	45,456.13	101.01%
3	补充流动资金	公司	65,000.00	65,000.00	100.00%
4	高端半导体设备拓展研发项目	公司	73,087.15	74,394.64	101.79%

5	盛美韩国半导体设备研发与制造中心	ACM Research Korea CO.,LTD.（以下简称“盛美韩国”）	24,500.00	0	0.00%
合计			327,587.15	306,500.07	-

注：上述募集资金累计投入进度大于100%的原因系使用了募集资金账户中的理财收益和利息收入。

四、本次募集资金用途变更涉及项目情况及募集资金变更情况

（一）“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”情况

公司于2023年2月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司以超募资金人民币24,500.00万元（折合韩元约462.95亿，暂以董事会审议日汇率测算，具体外币金额以增资当日汇率为准）向全资孙公司盛美韩国增资以新建并实施“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目（以下简称“本项目”），并同意通过技术许可的方式，将现有成熟技术授权于盛美韩国，应用到本项目的研发生产中。该议案于2023年3月29日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的公告》（公告编号：2023-015）。

本项目原计划总投资24,500.00万元，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金中的超募资金。截至本公告披露日，该项目募集资金尚未投入。

（二）“盛美半导体设备研发与制造中心”情况

根据《盛美上海首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，“盛美半导体设备研发与制造中心”原计划总投资额88,245.00万元，其中使用募集资金70,000.00万元。公司于2023年10月26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意使用超募资金人民币50,000.00万元用于“盛美半导体设备研发与制造中心”建设及调整项目实施进度。该议案于2023年11月28日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金增

加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-043）。调整后“盛美半导体设备研发与制造中心”总投资额为156,890.00万元，其中使用募集资金投入120,000.00万元，剩余部分由公司自有资金或自筹资金补足。截至2024年9月30日，该项目已累计投入募集资金121,649.30万元（含利息），募集资金投入进度为101.37%。

（三）募集资金变更情况

“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”终止后，公司将本项目拟投入募集资金24,500.00万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“盛美半导体设备研发与制造中心”项目建设。变更后，“盛美半导体设备研发与制造中心”总投资额维持156,890.00万元不变，募集资金投入金额将增加至144,500.00万元，剩余部分由公司自有资金或自筹资金补足。

五、本次终止及变更募集资金用途的原因

（一）终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目的原因

1、本项目涉及境外投资，需要将资金转至境外并存放在境外银行，这要求公司、保荐机构、盛美韩国与境外银行签署募集资金四方监管协议。然而，由于中韩两国法律制度存在差异，公司在寻找合格的境外银行以及四方监管协议的拟定、签署方面遇到了一定难度。经过各方多轮磋商，募集资金四方监管协议直到2024年6月末才完成签署。这一延迟影响了项目资金的及时到位，进而推迟了项目的建设实施。

2、由于2024年上半年全球营商环境的变化，公司经审慎评估后认为，此时通过“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目对盛美韩国进行大规模固定资产投资将面临风险。2024年12月2日公司及盛美韩国被美国工业和安全局（BIS）列入“实体清单”，也印证了公司前期的预判。

基于上述原因，为了更好地维护公司和股东的利益，规避因全球营商环境变化带来的风险，提高募集资金使用效率，公司经过审慎研究决定终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目。公司将继续关注海外市场的发展机会，并将优化全球布局策略，以更稳健、灵活的方式推进国际化发展。

（二）变更募集资金至“盛美半导体设备研发与制造中心”项目的原因

“盛美半导体设备研发与制造中心”项目建筑主体基本完工，后续还剩余部

分建筑的内部装修、部分设备的采购和调试安装、建筑顶部和周围的绿化工程尚待完成。为保障项目顺利推进，加快项目整体投产进度，公司拟将原计划投入“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”的募集资金24,500.00万元变更用于“盛美半导体设备研发与制造中心”。本次变更是基于提高募集资金使用效率和优化资源配置的考虑，有助于加快项目建设进度，确保公司产能建设目标的实现。

六、本次变更对公司的影响

本次拟终止“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目，并将该项目拟投入募集资金24,500.00万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)变更用于“盛美半导体设备研发与制造中心”建设，是公司结合全球营商环境以及整体发展战略布局等客观情况作出的审慎决策。这一变更旨在规避潜在风险并进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，加快项目建设进度。

本次项目变更是基于审慎原则作出的决定，将有助于加快盛美半导体设备研发与制造中心形成研发和生产能力，进一步增强核心竞争力，不会对公司现有业务的正常开展产生实质性不利影响。公司将持续加强对项目建设进度的监督管理，确保募集资金使用效益最大化，推动公司战略目标的稳步实现，切实维护全体股东的长远利益。

七、相关审批程序和意见

(一) 相关审议程序

公司于2025年1月9日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”，并将该项目拟投入募集资金24,500.00万元变更至首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”。本议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

(二) 监事会意见

监事会认为：本次终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目事项是公司在全球半导体行业形势变化及战略调整的背景下做出的审慎决策。此举旨在规避潜在风险、优化资源配置、提升资金使用效率，并进一步聚焦公司核心业务，

符合公司长期发展战略。本次募投项目变更已履行必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规。同时，本次变更有助于提升募投项目建设质量和效率，确保公司整体发展目标的实现，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的事项无异议。

八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的核查意见》

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2025年1月11日